



Versatz / displacement	Toleranz / tolerance
Fräskante zu Bohrungen milled edge to holes	± 0.2
Fräskante zu Leiterbild milled edge to conductive pattern	± 0.3
Ritzkante zu Bohrungen score edge to holes	± 0.3
Bohrungen holes	± 0.1
Bohrungen zu Leiterbild holes to conductive pattern	± 0.15

- 1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstoplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist
- 2) Toleranz für Fräskante: 16 ± 0.2
tolerance for milled edge: 16 ± 0.2
- 3) Toleranz für Bohrungsabstand ($\phi 2.5 \pm 0.05$): 16 ± 0.1
tolerance for hole pitch ($\phi 2.5 \pm 0.05$): 16 ± 0.1
- 4) Toleranz für Ritzkante: 43 ± 0.3
tolerance for score edge: 43 ± 0.3
- 5) Toleranz für Bohrungsabstand: 43 ± 0.1
tolerance for hole pitch: 43 ± 0.1
- 6) restliche Bauteilhöhe max. 1.5mm
remaining component height max. 1.5mm

 Sperrfläche für Bauteile (Bauteile können bis an Sperflächen angrenzen)
blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces)

				Tel.		Massstab 5:1	
				Datum	18.01.11		
				Bearb.	Grassl		
				Gepr.	SK 03.12.2014		
				Norm.			
1				EnOcean GmbH		A42-C01	
Zust.		Mitteilung		Datum		Name	
						</	